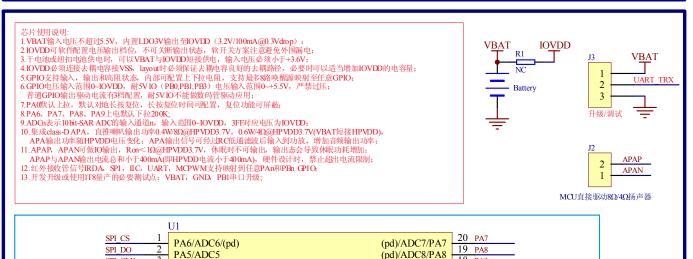
版本更新说明		
版本号	更新日期	更新点:
V1.0	2023.0713	原始版本
V1.1	2023.09.05	更新芯片使用说明,增加AD174A0封装

产品设计安全规范:

- .元器件物料必须保证质量,电容耐压值应大于最大工作电压一倍以上;
- 2.锂电方案必须带锂保,如果电池不带锂保,硬件设计需添加过流过放电路。 3.外露接口和后焊物料:电池,喇叭等,做好静电和浪涌保护措施, 整机ESD应符合最低标准,接触±4K,空气±8K。



18 PA9

17 PA10

16 PA11

15 LED

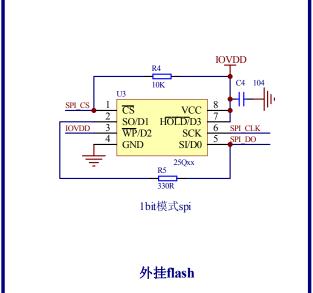
**MCU** 

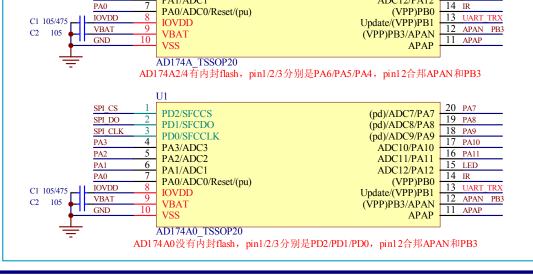
(pd)/ADC9/PA9

ADC10/PA10

ADC11/PA11

ADC12/PA12





3

4

6

PA4/ADC4

PA3/ADC3

PA2/ADC2

PA1/ADC1

SPI\_CLK

PA3

PA2

PA1

